

证券代码：688372

证券简称：伟测科技

公告编号：2026-077

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：伟测科技上海总部基地二期项目
- 投资金额：10 亿元（包含土地出让金、厂房建设及设备购置费等，

最终以实际投资额为准）

- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易已经上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“伟测科技”）第三届董事会战略委员会第一次会议、第三届董事会第七次会议审议通过。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、本项目所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及用地程序办理，需根据法定的“招、拍、挂”程序取得建设用地使用权。本项目投资、实施是以公司竞得项目用地使用权为前提，土地使用权能否竞得、最终成交面积、价格及取得时间均存在不确定性。

2、本项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环境影响评价批复、建设工程规划许可等审批程序，如因国家或地方政策调整，项目审批与实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

3、本次项目预计投入金额较大，若公司需要通过融资方式解决资金问题，会导致财务费用增加，进而可能对公司净利润和主要财务指标产生不利影响，并且若资金筹措、信贷政策、融资渠道等发生变化，可能对项目建设进度及整体推进造成不利影响。

4、本次投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断所做的决定，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化、内部管理等内外部因素均存在一定的不确定性，可能存在公司新增产能将存在无法及时消化的风险，进而将直接影响本项目的经济效益和公司的整体经营业绩。

5、本项目涉及的投资规模、建设周期等均为预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

集成电路测试是连接芯片设计、晶圆制造、封装及量产交付的重要环节，是保障芯片性能、良率和可靠性的关键支撑能力。为全面提升复杂芯片产品的测试覆盖率、自动化水平、测试效率及量产适配能力，扩大公司测试产能及市场竞争力，并且为了结束总部长期租赁状态，通过自建基地来降低运营成本、提升管理效能，公司开展了“伟测科技上海总部基地项目”，具体内容分别见公司于 2025 年 3 月 19 日、2025 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟购买土地使用权并投资建设上海总部基地项目的公告》（公告编号：2025-006）、《关于投资建设上海总部基地项目的进展公告》（公告编号：2025-051）。

本次投资旨在满足公司中长期发展需求，提升后续测试生产空间、研发验证空间、动力保障空间、仓储物流空间及配套服务空间。公司拟在上海市浦东新区合庆镇西北部，投资伟测科技上海总部基地二期项目，毗邻总部一期厂区建设，属于结合企业业务发展节奏、产能扩张需求和园区整体布局作出的延伸性安排。一期厂房目前正在进行厂房的装修与机电安装工作。本次投资为伟测科技上海总部基地二期项目，拟投资金额为 10 亿元（包含土地出让金、厂房建设及设备购置费等，最终以实际投资额为准）。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） --增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☒ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	伟测科技上海总部基地二期项目
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：100,000.00（以实际投资额为准） ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☒ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☒ 其他：其他符合法律法规规定的方式
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

公司于2026年10月27日召开了第三届董事会第七次会议，并经第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次投资项目名称为伟测科技上海总部基地二期项目。项目总投资约100,000.00万元。项目预计2027年7月开工建设，建设周期预计为18个月，即

从开工日期起算，项目预计在 2028 年 12 月完成建设并开始投产。实际开工时间及建设进度以项目最终实施情况为准。

（二）投资标的的具体信息

（1）项目基本情况

投资类型	☒ 投资新项目
项目名称	伟测科技上海总部基地二期项目
项目主要内容	购买土地、新建厂房及配套设施和测试设备
建设地点	上海市浦东新区合庆镇西北部
项目总投资金额（万元）	100,000（包含土地出让金、厂房建设及设备购置费等，最终以实际投资额为准）
上市公司投资金额（万元）	100,000（包含土地出让金、厂房建设及设备购置费等，最终以实际投资额为准）
项目建设期（月）	18
预计开工时间	2027 年 7 月
是否属于主营业务范围	☒ 是 ☐ 否

（2）各主要投资方出资情况

公司为本项目投资建设的唯一主体，无其他投资方。

（3）项目目前进展情况

本项目尚处于准入申请环节。后续，公司将参与土地使用权招拍挂手续、依法依规取得项目建设用地使用权、开展环评等政府相关主管部门的审批或备案工作。

（4）项目市场定位及可行性分析

本项目主要用于提高公司集成电路测试服务产能、效率和交付能力。本项目在技术方向、市场需求、实施条件和财务安排等方面均具备较好的可行性。项目建设内容符合集成电路测试高端化、自动化、平台化和量产化的发展趋势，能够有效支撑先进封装产品测试能力提升，具有较好的实施基础和产业化前景。

（三）出资方式及相关情况

本项目资金来源为公司自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，投资总额约为 10 亿元（以实际投入金额为准）。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目实施后，公司集成电路测试能力将进一步增强，有利于提升中高端芯片测试覆盖能力和规模化交付能力。项目实施后将进一步扩大公司高端测试产能，提升复杂芯片测试、自动化测试平台和量产导入能力，有利于完善区域集成电路产业链配套、增强高端测试自主服务能力，并形成较好的产业贡献、经济效益和社会效益。

本次投资不会对公司当前财务状况及经营成果产生不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。本项目目前尚处于筹备阶段，预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。项目未来实际运营过程中，可能面临宏观经济环境变化、行业政策调整、市场需求波动、行业竞争加剧、技术研发进展不及预期等不确定性因素，导致项目推进进度延迟或实际效益不及预期，进而对公司前期投入资金的回收和预期效益的实现产生不利影响。

四、对外投资的风险提示

1、本项目所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及用地程序办理，需根据法定的“招、拍、挂”程序取得建设用地使用权。本项目投资、实施是以公司竞得项目用地使用权为前提，土地使用权能否竞得、最终成交面积、价格及取得时间均存在不确定性。

2、本项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环境影响评价批复、建设工程规划许可等审批程序，如因国家或地方政策调整，项目审批与实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

3、本次项目预计投入金额较大，若公司需要通过融资方式解决资金问题，会导致财务费用增加，进而可能对公司净利润和主要财务指标产生不利影响，并且若资金筹措、信贷政策、融资渠道等发生变化，可能对项目建设进度及整体推进造成不利影响。

4、本次投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断所做的决定，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化、内部管理等内外部因素均存在一定的不确定性，可能存在公司新增产能将存在无法及时消化的风险，进而将直接影响本项目的经济效益和公司的整体经营业绩。

5、本项目涉及的投资规模、建设周期等均为预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

公司将密切跟进项目各环节进展，合理安排资金，严格把控风险，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日